## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07302929 A

(43) Date of publication of application: 14 . 11 . 95

(51) Int. CI

H01L 33/00

(21) Application number: 07046785

(22) Date of filing: 07 . 03 . 95

(30) Priority:

08 . 03 . 94 JP 06 36833

(71) Applicant:

SUMITOMO CHEM CO LTD

(72) Inventor:

IECHIKA YASUSHI TAKADA TOMOYUKI

ONO YOSHINOBU

## (54) III-V COMPOUND SEMICONDUCTOR AND LIGHT **EMITTING DEVICE**

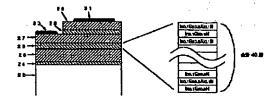
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain not only a III-V compound high in quality and large in surface area but also a light emitting diode high in luminous efficiency by a method wherein a III-V compound semiconductor is grown on a specific laminated structure.

CONSTITUTION: A buffer layer 26 is interposed between a layer having a light emitting layer 28 and charge injection layers 27 and 29 and a substrate 22. The light emitting layer 28 is represented by a general formula,  $In_xGa_vAl_zN$  (0<x $\leq$ 1, 0 $\leq$ y<1, 0 $\leq$ z<1, x+y+z=1), and the charge injection layers 27 and 29 are represented by a general formula,  $\ln_x Ga_v Al_z N (0 < x \le 1, 0 \le y', 1, 0 \le z' < 1,$ x'+y'+z'=1), and formed of III-V compound semiconductor which has a larger band gap than the light emitting layer 28. The buffer layer 26 is represented by a general formula,  $ln_uGa_vAl_wN$  (0< $u_{\underline{\approx}}1$ , 0 $\leq$ v<1, 0 $\leq$ w<1, u+v+w=1), and of laminated structure at least composed of two layers different from each other in composition, wherein a formula, w>0, is satisfied at least in one of the above layers. By this setup, a III-V compound

semiconductor of high quality can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-302929

(43)公開日 平成7年(1995)11月14日

(51) Int.Cl. 4

識別記号

· **庁内整理番号** 

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

С A

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号

特顯平7-46785

(22)出顧日

平成7年(1995) 3月7日

(31) 優先権主張番号 特願平6-36833

(32) 優先日

平6 (1994) 3月8日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71) 出版人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72)発明者 家近 寮

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(72)発明者 高田 朋幸

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(72) 発明者 小野 善伸

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(74)代理人 弁理士 久保山 隆 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 3-5族化合物半導体と発光素子

## (57)【要約】

【目的】Inを含む高品質の3-5族化合物半導体及び これを用いた高い発光効率を有する発光素子を提供す

【構成】発光層と電荷注入層とを有する層と、基板との 間に、パッファ層を有し、発光層が一般式 Inx Gay  $Al_z N ( \pm \psi, 0 < x \le 1, 0 \le y < 1, 0 \le z < 1)$ 1、x+y+z=1)で表される3-5族化合物半導体 であって、電荷注入層が一般式 In x Ga v A l z N (式中、 $0 < x' \le 1$ 、 $0 \le y' < 1$ 、 $0 \le z' < 1$ 、 x' + y' + z' = 1) で表され、発光層よりも大きな パンドギャップを有する3-5族化合物半導体であっ て、パッファ層が、一般式 I n u G a v A l w N (式  $\ \, + \, , \ \, 0 < u \leq 1 \, , \ \, 0 \leq v < 1 \, , \ \, 0 \leq w < 1 \, , \ \, u + v + w$ = 1)で表され、少なくとも2つの組成の異なる層から なり、少なくとも1つの層においてw>0である積層構 造を含むことを特徴とする3-5族化合物半導体。

【特許請求の範囲】

6

、【請求項1】 発光層と電荷注入層とを有する層と、基の間に、パッファ層を有し、発光層が一般式 I  $n_x$  I n

【請求項2】 パッファ層が、少なくとも4つの層からなることを特徴とする請求項1 記載の3 - 5 族化合物半導体。

【請求項3】 バッファ層が、  $I n_u G a_v A l_w N (式 中、0 <math>\leq u < l$ 、0  $\leq v < l$ 、0  $\leq w < l$ 、u + v + w = 1) 層と  $I n_u G a_{v'} A l_{w'} N (式 中、0 <math>\leq u' < l$ 、u + v + w' = 1、0  $\leq v' \leq l$ 、0  $\leq w' \leq l$ 、u' + v' + w' = 1) 層とが交互に少なくとも2回繰り返された積層構造であることを特徴とする請求項1記載の3 - 5 族化合物半導体。

【請求項4】 サファイア基板上に形成された GaN層上に、形成されたことを特徴とする請求項 1 記載の 3 - 5 族化合物半導体。

【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載の3-5族 化合物半導体を用いた発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、3-5族化合物半導体及びこれを用いた発光素子に関する。

[0002]

【0003】そこで、該3-5族化合物半導体結晶を成 50

及させる基板としては、現状では格子定数が整合する選切な材料がないので、六方晶系の3-5族化合物半導体と同じ六方晶系のサファイアを基板を用いることが検討されている。しかしながら、良質の3-5族化合物半導体結晶は未だ得られておらず、特に表示用途に供し得る程度までInを高濃度に含む系では、まだ実用に供し得るような高品質の結晶が得られていない。

[00041

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、In 10 を含む高品質の3-5族化合物半導体及びこれを用いた 高い発光効率を有する発光素子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明者らはこのような状況をみて鋭意検討の結果、特定の積層構造上に3-5族化合物半導体を成長することにより、高品質で大面積の3-5族化合物半導体が得られることを見出し本発明に至った。すなわち、本発明は、次に記す発明である。 【1】発光層と電荷注入層とを有する層と、基板との間

【0006】 [2] パッファ層が、少なくとも4つの層からなることを特徴とする [1] 記載の3-5 族化合物 半導体。

【0007】 [4] サファイア基板上に形成された GaN B上に、形成されたことを特徴とする [1] 記載の 3-5 族化合物半導体。

[5] 前記[1] ~ [4] のいずれかに記載の3-5族 化合物半導体を用いた発光素子。

【0008】 次に本発明を詳細に説明する。本発明の3-5 族化合物半導体は、発光層と電荷注入層とを有する層と、基板との間に、パッファ層を有する。 発光層は、一般式  $I_{n_x}$  Gay  $A_{n_x}$  N (式中、0<x $\le$ 1、0 $\le$ y<1、0 $\le$ z<1、x+y+z=1) で表される3-5 族化合物半導体である。電荷注入層は、一般式  $I_{n_x}$ 

6.3

Ga<sub>y'</sub>Al<sub>z'</sub>N(式中0<x'≤1,0≤y'<1,0 <sub>ε</sub> ≦ z ′ < 1 、 x ′ + y ′ + z ′ = 1 )で表され、発光層 に接し発光層よりも大きなパンドギャップを有する3-5族化合物半導体である。電荷注入層は発光層より大き なパンドギャップを持つため、光の照射により本発明の 半導体内に発生した電荷または外部電源により供給され た電荷を効率よく発光層に注入し閉じこめる働きがあ る。パッファ層は、一般式Inu Gav Alw N (式 +,  $0 < u \le 1$ ,  $0 \le v < 1$ ,  $0 \le w < 1$ , u + v + w= 1) で表され、少なくとも2つの、組成の異なる層か

【0009】特に、発光層の一般式Inx Gay Alz Nで表される3-5族化合物半導体において、Inの組 成が10~80モル% (0.1≤×≤0.8) の場合に は、発光波長を紫色及びそれより長波長の可視領域にす ることができるので、発光素子用途に好ましい。具体的 には、発光波長を紫色、青色、緑色、黄色、橙色にする ことができる。特に、背色、緑色の発光素子用として重 要である。

らなる積層構造を含むものである。

【0010】発光層と電荷注入層との、基板面と平行方 20 向の格子定数の差は 0.3%以下であることが好まし い。 該格子定数の差が 0.3%を超えると、接合界面で 欠陥が発生しやすいので好ましくない。本発明における パッファ層は、少なくとも 2 つの、組成の異なる層から なる積層構造を含み、該積層については、好ましくは4 **層以上積層すること、さらに好ましくは10層以上積層** することがよい。また、積層の数があまりに多すぎて も、原料の切り替えに要する合計の時間が長くなり、生 産性が悪くなるので、該積層構造に含まれる層の数は1 000以下が好ましい。また、該積層の合計の厚みは、 100Å~5μmの範囲が好ましい。100Å未満では 積層した効果が十分ではなく、5μmを超えると成長に 要する時間が長くなり生産性が悪くなるので好ましくな い。 Gaを含む3-5 族化合物半導体では、GaをAl で置き換えてもあまり大きな格子定数の変化はないのに 対して、Ga又はAlをInで置き換えた場合、大きな 格子定数の差が生じる。したがって、積層構造に用いる。 組成はInの割合についてはあまり変化させず、Gaと・ Alの組成を変化させることが好ましい。具体的には、 パッファ唇が、Inu Gay N層とInu Aly N層 (式中、u + v = 1、0 < u < 1、0 < v < 1) とが交 互に少なくとも2回繰り返された積層構造である3-5 族化合物半導体が好ましい。

【0011】 電荷注入層と発光層との半導体パンドギャ ップは、 0. 1 電子ポルト(以下「eV」と記すことが ある。)以上あることが好ましい。さらに0.3 e V以 上あることが好ましい。 0. 1 e V未満では電子又は正 孔は電荷注入層と発光層との界面に閉じ込められにく く、電荷の発光層内での再結合効率が低くなるので好ま しくない。また、発光層の一方の面だけでなく、両方の 50 面を電荷注入層で接合させる、いわゆるダブルヘテロ接 合構造とすることで、さらに電荷の閉じ込めを効率的に 行なうことができ、電荷の再結合効率を高めることがで きる。この場合も、発光層に対する電荷注入層の禁制帯 の幅の差は0.leV以上、さらに好ましくは0.3e V以上あることが好ましい。

【0012】本発明の3-5族化合物半導体結晶は、基 板の上に成長させて得られるが、用いる基板について は、SiC、Si、サファイア、スピネル、2n0等を 用いることができる。特に、サファイア上に成長させた GaN層の上に該3-5族化合物半導体を成長させた3 - 5 族化合物半導体が好ましく、サファイア上にAIN 等の薄膜をパッファ層として成長させたGaN層の上に 該3-5 族化合物半導体を成長させた3-5 族化合物半 導体がさらに好ましい。 本発明の3-5族化合物半導体 を用いた発光素子は、高密度に電子と正孔を閉じ込める ことができる3-5族化合物半導体を用いるので発光効 率が向上する。

【0013】本発明の3-5族化合物半導体の製造方法 としては、分子線エピタキシー(以下、「MBE」と記 す。)法、有機金属気相成長(以下、「MOVPE」と 記す。) 法などが挙げられる。MBE法を用いる場合、 窒素原料としては、窒素、アンモニア、およびその他の 窒素化合物を気体状態で供給する方法である気体ソース 分子線エピタキシー (以下、「GSMBE」と記す。) 法が一般的に用いられている。この場合、窒素原料が化 学的に不活性で、窒素原子が結晶中に取り込まれにくい ことがある。その場合には、マイクロ波などにより窒素 原料を励起して、活性状態にして供給することで、窒素 30 の取り込み効率を挙げることができる。

【0014】MOVPE法を用いて本発明の3-5族化 合物半導体を製造する場合には、以下のような原料を用 いることができる。すなわち、3族原料としては、トリ メチルガリウム {Ga (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>、以下「TMG」と 記すことがある。〕、トリエチルガリウム  $\{Ga(C_2)\}$  $[H_5]_3$  }、等の一般式 $R_1$   $R_2$   $R_3$  G a (ここで、R $_1$  、  $R_2$  、  $R_3$  はアルキル基)で表されるトリアルキル ガリウム;トリメチルアルミニウム (A1 (C  $H_3$ )  $_3$ 、以下「TMA」と記すことがある。〕、トリ プチルアルミニウム (A 1 (i - C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> )<sub>3</sub> ] 等の一 般式R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> R<sub>3</sub> A 1 (ここで、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub> はア ルキル基)で表されるトリアルキルアルミニウム;トリ メチルアミンアラン  $\{A \mid H_3 \mid N \mid (C \mid H_3 \mid)_3 \}$ ; トリ メチルインジウム [In (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>、以下「TMI」 と記す。〕トリエチルインジウム〔In(C  $_{2}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{2}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{2}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$ 1 、  $R_2$  、  $R_3$  はアルキル基)で表されるトリアルキル インジウム等が挙げられる。これらは単独または混合し

て用いられる。

【0015】 次に5族元素としては、アンモニア、ヒド ラジン・メチルヒドラジン、1、1-ジメチルヒドラジ ン、1、2-ジメチルヒドラジン、tープチルアミン、 エチレンジアミンなどが挙げられる。これらは単独また は混合して用いられる。n型ドーパントとしては、S i、Ge等の4族元素、S、Se等の6族元素を用いる ことができる。 p -型ドーパントとしては、 B e 、 M .g、Zn、Cd、Hgなどを用いることができる。 【0016】MOVPE法の場合、Si原料としてはシ ラン (SiH<sub>4</sub>)、ジシラン (Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) 等、Ge原 料としてはゲラン ( $GeH_4$ ) 等、 S 原料としては、 歳 化水素 (H<sub>2</sub> S)、ジメチル硫黄 ((CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> S)、 ジエチル硫黄  $\{(C_2 H_5)_2 S\}$  等の一般式  $R_1 R_2$ S(ただしR」R っ はアルキル基)で表されるジアルキ ル硫黄、Se原料としては、セレン化化水素 (H<sub>2</sub> S e)、 $\mathcal{Y}$   $\mathcal{F}$   $\mathcal{N}$   $\mathcal{T}$   $\mathcal{N}$   $\mathcal{N}$ セレン [( $C_2$   $H_5$ )  $_2$  Se]、等の一般式 $R_1$   $R_2$  Se (ただし $R_1$   $R_2$  はアルキル基) で表されるジアルキ

ルセレン等が挙げられる。

【0018】 Cd用原料としては、ジメチルカドミウム 30 ((CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Cd) 等の一般式R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> Cd(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> はアルキル基)で表さられるアルキルカドミウムなどが挙げられる。Be用原料としては、ジエチルベリリウム((C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> Be)、ピスメチルシクロペンタジエニルベリリウム((CH<sub>3</sub> C<sub>5</sub> H<sub>4</sub>)<sub>2</sub> Be)などが挙げられる。Hg用原料としては、ジメチル水銀((CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Hg)、ジエチル水銀((C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> Hg)等の一般式R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> Hg(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> はアルキル基)で表されるアルキル水銀などが挙げられる。

より低抵抗にすることができる。本発明の発光素子は、 前記の本発明の3-5族化合物半導体を用いたものであ り、公知の方法で作製することができる。 具体的な例を 図2に示す。ここでは、サファイア基板22の上に、順 にA 1 N パッファ層 2 4 、 G a N 層 2 5 、 I n <sub>0.1</sub> G a 0.9 NとIn<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.8</sub> Al<sub>0.1</sub> Nの積層構造からな るパッファ暦26、InGaAIN電荷注入層27、I n G a N 発光層 2 8 、 I n G a A I N 電荷注入層 2 9 を 成長させる。ここで、GaN磨25から電荷注入層27 まではn型の、電荷注入層29はp型の不純物をドープ する。次に、こうして作製した該化合物半導体を常法に したがい部分的にエッチングし、さらにInGaAlN 電荷注入層27の上にn電極30を形成し、InGaA 1 N 電荷注入層 2 9 の上に p 電極 3 1 を形成する。図 2 では電極30は電荷注入層27の上に設けているが、電 極 3 0 を 設ける 層 は A 1 N 層 2 4 を 除 く 発 光 層 2 8 よ り。 サファイア基板22の側の層であればどの層でもよい。

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明する。なお、実施例は一つの例示であって、本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の変更又は改良を行いうることは言うまでもない。

## 実施例 1

ここで用いたMOVPE装置の概略を図1に示す。用い た原料はアンモニア、TMG、TMA、TMIであり、 またSiドープのために水楽で1ppmに希釈したシラ ンガスを、MgドープのためにMCp2Mgを用いた。 まず、有機洗浄により洗浄したC面を主面とする単結晶 のサファイア基板 2 2 を M O V P E 装置の 反応 室 1 9 に 載置されたサセプタ21に装着した。 次に、常圧で水素 を反応室に流しながら高周波加熱によりサセプタを11 00℃に加熱し、この状態でサファイア基板を10分間 保持してサファイア基板を気相クリーニングした。次 に、温度を600℃まで低下させて、アンモニアとTM Gを供給して約500人の厚さの窒化ガリウムのパッフ ァ層を形成した。次に、TMGの供給のみを停止して、 サファイア基板の温度を1100℃まで昇温し、温度が 安定したのち、TMGの供給を開始し、3μmの膜厚の CaN膜を成長した。こうして得られたサファイア基板 とGaNとをあわせて本発明における基板とする。

【0021】次に、TMGの供給のみを止め800℃まで降温したのち、キャリアガスを水素から窒素に変え、TMG、TMIの供給を開始して、In<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.9</sub> Nの層を100Å成長した。続いて、TMG、TMI、TMAを供給して、In<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.8</sub> Al<sub>0.1</sub> Nの層を100Å成長した。この操作を交互に20回繰り返して、In<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.9</sub> N層が20層、In<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.8</sub> Al<sub>0.1</sub> N層が20層からなる積層構造を成長した。次に、TMG、TMA、TMI、シランガス、MCp2Mgを用いてSi 濃度が1×10<sup>19</sup>/cm<sup>3</sup>のIn<sub>0.1</sub> Ga

0.8 A l 0.1 Nの電荷注入層を1800Å、Si濃度が r 1×10<sup>19</sup>/cm³のIn<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.9</sub> Nの発光層を5 0 0 Å、Mg 没度が 1 × 1 0 <sup>20</sup>/ c m <sup>3</sup> の G a N の 層 を 1800Å、成長させた。成長終了後、窒素中800℃ でアニール処理を行ない、MgをドープしたGaN層を 低抵抗化した。こうして得られた3-5族化合物半導体 基板を用いて、通常の半導体プロセスにより図2に示す 構造の発光素子を作製した。この素子について、p-電 極を電源の+側、n-電極を-側に接続し5Vを引加し たところ 1 0 m A の電流が流れた。このとき青紫色の発 10 光が忍められ、この状態で発光部の輝度を輝度計により。 測定した結果、17mcdであった。

#### 【0022】比較例1

GaN層成長後にIn<sub>0.1</sub> Ga<sub>0.9</sub> NとIn<sub>0.1</sub> Ga 0.8 Al0.1 Nからなる積層構造を成長しないことを除 いては実施例1と同様にして発光素子を作製した。実施 例1と同様にして10mAの電流を流し、基板倒から素 子の状態を観察したところ、やはりp-電極付近から青 紫色の発光が見られたが、 実施例 1 と同様にして発光部 の輝度を輝度計により測定した結果、6mcdであっ た.

#### 【0023】 実施例2

実施例1と同様にして、本発明のパッファ層として【n 0.17 G a 0.83 N & 3 0 Å & I n 0.17 G a 0.75 A 1 0.08 N を30人とを交互に20回、合計40層成長し、さらに 第 1 の電荷注入層 I n <sub>0.17</sub>G a <sub>0.83</sub>N を 3 0 Å 、発光層 として I n <sub>0.25</sub> G a <sub>0.75</sub> N を 5 0 Å、 第 2 の **電**荷注入層 としてGaNを200人成長した。第1の電荷注入層と 発光層とのパンドギャップの差は約0.16eV、第2 の電荷注入層と発光層のパンドギャップの差は約0.5 30 e Vである。

【0024】こうして得られた試料を、He-Cdレー ザ(波長325 n m、出力10 mW)を励起光激として 液体窒素温度でフォトルミネッセンススペクトル(以 下、「PL」と記すことがある。)を測定したところ、 発光層に由来する明瞭な青色発光を示し、中心波長は4 3 1 5 Å、ピーク強度(ピーク波長での検出器の出力)ご は4.15mVであった。

### 【0025】比較例2

GaN上に直接、発光層としてIn<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>Nを5 40 O A 成長したことを除いては実施例 2 と同様にして成長 を行った。本実施例の場合、第1の電荷注入層はGaN である。実施例1と同様にPLによる評価を行なったと ころ、やはり明瞭な青色発光を示したが、ピーク強度は 1.6mVしかなかった。この結果を実施例2と比較す ることで、本発明の3-5族化合物半導体における発光 層の結晶性が比較例2に比べて大きく改善されているこ とがわかる。

## 【0026】実施例3

本発明のパッファ層の上に直接発光層を成長したことを 50 2.2・・・サファイア基板

除いては実施例2と同様にして、本発明の半導体を作型 した。また、パッファ層を10回(合計20層)及び4 0回(合計80層)繰り返した同様の試料を作製した。 本実施例の場合、パッファ層の最後の層が第1の電荷注 入層としての作用を持つ。第1の電荷注入層と発光層の パンドギャップの差は約0.3eVである。これらの試 料および比較例2の試料を実施例2と同様にして室温で のPLによる評価を行なった。図3にパッファ層の層数 とピーク強度の関係を示す。比較例のピーク強度もこの 図の層数0の位置に示してある。この図から本発明によ る半導体の結晶性が比較例2に比べて向上していること がわかる。

### [0027]

【発明の効果】本発明の3-5族化合物半導体は、In を含む高品質で大面積の3-5族化合物半導体であり、 これを用いた発光素子は高い発光効率を有する。特に、 本発明の発光業子は、3-5族化合物半導体におけるI nの組成が10~80モル%の場合には、発光波長を紫 色及びそれより長波長の可視領域すなわち青色、緑色、 20 黄色、橙色などにすることができる。特に、本発明の発 光素子は、青色、緑色用として工築的に重要である。

#### 【図面の館単な説明】

【図1】本発明の半導体発光素子で用いる3-5族化合 物半導体の製造装置の概略図。

【図2】本発明の発光素子の構造の一例を示す振路図。 【図3】 パッファ層の層数とPLピーク強度との相関を

## 【符号の説明】

1 ・・・マスフローコントローラー

2・・・恒温層

3 · · · TMGパプラー

4 ・・・マスフローコントローラー

5・・・恒温層

6 · · · T M A パプラー

7・・・マスフローコントローラー

8・・・恒温層

9···TMIパブラー

10・・・マスフローコントローラー

11・・・恒温層

12 · · · M C p 2 M g パブラー

13・・・シランポンベ

14・・・調圧弁

15・・・マスフローコントローラー

16・・・アンモニアポンベ

17・・・調圧弁

18・・・マスフローコントローラー

19・・・反応炉

20・・・高周波コイル

21. . . . サセプター

9

10

23 ・・・排気孔

24・・・A1Nパッファ層

2 5 · · · G a N 層

 $\begin{smallmatrix}2&6&\cdots&1&n&0&1\\&&&&&1&0&1\end{smallmatrix}$ 

0.1 Nの積層構造からなるパッファ層

27・・・In GaAlN電荷注入層

28・・・In GaN発光層

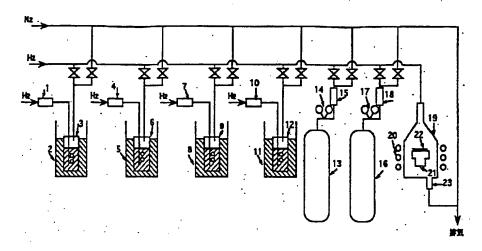
29···In GaAlN電荷注入層

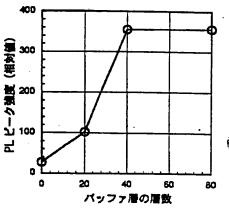
30 · · · n **健**極

3 1 ・・・p 就極

[图1]

[図3]





[図2]

